

Fit your needs, Fit your future

期待に応じて、未来を形に・・・

## 株主通信

# SPRING 2013

2013年3月期第3四半期決算報告

86号

# SCREEN NOW

SCREEN

## 株主の皆さまへ



平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2013年3月期第3四半期累計期間（2012年4月1日～12月31日）における事業環境は、半導体業界において、先行き不透明な経済状況やパソコン需要の低迷等により、多くの半導体メーカーの設備投資が大幅に減少しました。液晶パネル業界においても、パネル需給の悪化によりパネルメーカーが設備投資を抑制するなど事業環境は著しく悪化しました。

このような状況の中、当第3四半期累計期間における当社グループの売上高は1,257億円と前年同期に比べ475億円（27.4%）減少しました。利益面では、売上の大幅な減少により、営業損失は105億円（前年同期は96億円の営業利益）、経常損失は110億円（前年同期は90億円の経常利益）となりました。また、特別損失において保有株式の時価下落に伴う投資有価証券評価損を計上したことに加え、繰延税金資産の一部の取り崩しによる法人税等（税金費用）を計上したことから、四半期純損失は166億円（前年同期は25億円の四半期純利益）となりました。

既にご報告しておりますとおり、今期の期末配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきたいと存じます。当社グループでは、役員報酬の削減をはじめとする緊急対応策を実施するとともに、来期（2014年3月期）の黒字転換と復配を目指して、強固な収益体質を構築すべく構造改革を進めております。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

取締役社長 最高執行責任者（COO）

橋本 正博

## クローズアップ —収益改善に向けた取り組み—

2013年2月に発表いたしました、収益改善に向けた取り組みについてご説明します。

### ○ 現状認識

半導体業界は、パソコンからモバイル機器への移行に伴い、半導体の低価格化やシリコンサイクルの短期化、半導体メーカーの寡占化が進むなど、構造変化が顕著となっています。また、液晶パネル業界は、テレビ需要の低迷や低価格化の進行により市場の成長が鈍化してきています。このような外部環境の変化に対応するため、当社グループの収益力の向上や不採算事業の再生、バランスのとれた事業構造の確立など、収益体質の再構築が急務であると認識しております。

### ○ 目標

連結売上高が今期予想額である1,900億円を下回っても利益が出せる体質への変換を図り、2014年3月期に黒字転換および復配を目指します。

### ○ 目標達成に向けた施策

緊急対応策の実施により当面の収益を確保しつつ、強固な収益体質を構築すべく抜本的な構造改革を実行してまいります。具体的な内容は以下のとおりです。

#### 構造改革

1. 研究費、設備投資額の効率的活用の徹底
2. 組織のスリム化、人員の適正配置による人材活用強化
3. 生産改善、品質向上による変動費削減  
半導体機器事業の変動費率5ポイント改善
4. 事業構造の再構築  
新規事業の立ち上げと不採算事業の早期再生

#### 緊急対応策

1. 人件費削減  
役員報酬、賃金・諸手当のカット
2. 経費圧縮  
厚生費の削減等

### Q&A

2013年2月に開催された、機関投資家・アナリストさま対象の2013年3月期第3四半期決算説明会における質疑応答を掲載します。

### Q 今期の固定費の削減額は？また、下期は上期に比べてどの程度固定費を削減する見込みか？

A 前期に対して40億円弱程度の固定費削減を見込んでおります。上期に対して下期は十数億円の削減効果を見込んでおります。

### Q 構造改革および緊急対応策における削減目標額は？

A 今期予想に比べて来期は固定費で50億円の削減を計画しております。また、変動費に関しましては、各事業におきまして変動費率の低減に努めますが、特に主力の半導体機器事業におきましては今期予想に対して変動費率5ポイント低減を目指します。

## セグメント別業績(第3四半期累計:2012年4月1日~12月31日)

### 半導体機器事業

- 売上高 869億円(前年同期比23.3%減)
- 営業損失 △78億円(前年同期は98億円の営業利益)

- ▶半導体メーカーの設備投資が大幅に減少する中、半導体の微細化に寄与する枚葉式洗浄装置の売上は小幅な減少にとどまりましたが、バッチ式洗浄装置は大幅に減少しました。
- ▶利益面では、売上の大幅な減少に加え、製品構成の変化や工場操業度の低下等による利益率の悪化により、営業損失を計上しました。

#### 今後の見通しと取り組み

- ・ファンドリーの先端投資により積み上がった受注残を背景に、第4四半期(1-3月)の売上は、第3四半期(10-12月)に比べて大幅に増加する見込みです。
- ・売上拡大が見込まれる枚葉式洗浄装置「SU-3200」の変動費率の改善に取り組み、一層のコスト削減を図ります。

### FPD 機器事業

- 売上高 66億円(前年同期比73.1%減)
- 営業損失 △12億円(前年同期は5億円の営業損失)

- ▶大型パネル用製造装置に加え、高精細液晶パネル向け中小型用製造装置についても売上が減少したことから、前年同期に比べ売上が大幅に減少しました。
- ▶利益面では、エネルギー分野の開発部門を移管したことなどにより固定費が減少したものの、売上の大幅な減少が響き、営業損失が拡大しました。

#### 今後の見通しと取り組み

- ・第4四半期の売上は、中小型向け投資により大幅な増加を見込んでおります。
- ・来期(2014年3月期)の売上は、当第3四半期に大型案件を受注したことも寄与し、今期に比べ大幅に増加する見込みです。

### メディアアンドプレジジョンテクノロジー事業

- 売上高 315億円(前年同期比8.4%減)
- 営業利益 0億円(前年同期比98.7%減)

- ▶印刷関連機器は、CTP装置の売上は前年同期並みで推移しましたが、POD装置が減少したことにより、前年同期に比べ売上が減少しました。
- ▶プリント基板関連機器は、直接描画装置の売上が増加したことにより前年同期に比べ売上が増加しました。
- ▶利益面では、売上の減少により、営業利益は大幅に減少しました。

#### 今後の見通しと取り組み

- ・印刷関連機器では、CTP装置は販売経路別施策を実施し売上増加を目指します。POD装置は日本・オランダ・米国にあるショールームを活用し、直接販売を強化してまいります。
- ・プリント基板関連機器では、好調な直接描画装置の拡販に注力してまいります。

#### 用語解説

**枚葉式洗浄装置**: ウエハーを1枚ずつ処理する洗浄装置。

**バッチ式洗浄装置**: 複数のウエハーを一括で処理する洗浄装置。

**ファンドリー**: 半導体の受託生産を行う企業のこと。

**CTP**: Computer to Plateの略。印刷するデータをコンピューターから印刷用プレートに出力し、印刷版を作成する方法。

**POD**: Print on Demandの略。必要なときに必要な部数を印刷すること。

**直接描画装置**: 回路パターンを高速・高精細に直接描画(露光)する装置。従来の露光方式に比べ、納期の短縮やコストの大幅な削減が可能。

**イメージセンサー**: 光の明暗を電気信号に変換する半導体素子のこと。CCDセンサーやCMOSセンサーなどがある。

**CMOSセンサー**: イメージセンサーの一種。状態が変化したときにのみ電流が流れるという特質を持つため、CCDセンサーに比べて消費電力が少ない。

**パワー半導体**: 半導体の一種で、電力の制御や供給を行う。ハイブリッド自動車や、エアコンのインバーターなど、幅広く用いられる。

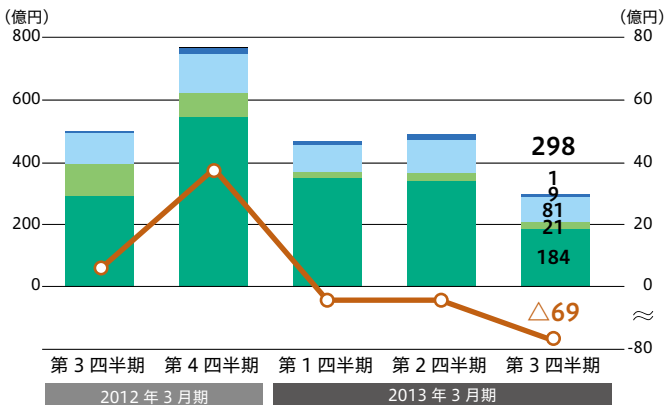
## ● 2013年3月期連結経営成績

(単位：億円未満切捨)

	第3四半期 2012年10月1日から 2012年12月31日まで	前年同期	第3四半期累計 2012年4月1日から 2012年12月31日まで	前年同期
売上高	298	502	1,257	1,732
営業損益	△69	6	△105	96
経常損益	△73	2	△110	90
四半期純損益	△75	△39	△166	25

## ● 売上高・営業損益

■半導体機器事業 ■FPD機器事業 ■メディアアンドプレジジョンテクノロジー事業  
 (■印刷関連機器 ■プリント基板関連機器) ■その他 ○営業損益[右目盛]



## ● 2013年3月期連結業績予想

2013年3月期の連結業績予想および配当予想につきましては、2012年11月5日に公表した数値から変更ありません。

(単位：億円)

	売上高	営業損失	経常損失	当期純損失
通期	1,900	△70	△75	△140

2013年3月期の期末配当につきましては、多額の損失を計上する見込みであることから、誠に遺憾ながら、無配とさせていただきます。

(注) 財務数値につきましては、金額は表示単位未満を切り捨て、比率は四捨五入して表記しております。

## 超薄型半導体ウエハーに対応する枚葉式洗浄装置を発売

近年、スマートフォンなどに搭載されるカメラ用イメージセンサー\*分野では、小型化と高解像度化を両立させる裏面照射型CMOSセンサー\*の需要が急増しています。また、ハイブリッド車などに不可欠なパワー半導体\*の需要も急速に拡大しています。これらの半導体製造工程では、ウエハーを薄く加工する必要があるため、洗浄プロセスにおいても超薄型ウエハーへの対応が急務となっています。

このような業界の動向を受けて、当社は超薄型半導体ウエハーに対応する枚葉式洗浄装置「SU-2000」を開発しました。今後も新たな分野に向けた製品ラインアップを充実させ、事業領域のさらなる拡大を図っていきます。



SU-2000

\*用語解説は、中面の「セグメント別業績」をご覧ください。

## 株価および出来高の推移



## 大日本スクリーン製造株式会社

〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上 4丁目天神北町1-1 電話075(414)7111

ホームページアドレス: www.screen.co.jp 証券コード 7735

SCREEN NOW Vol.86 発行日: 2013年3月12日(発行は3月、6月、9月、12月) 発行: IR室

「SCREEN NOW」(株主通信)は、当社のフォント「ヒラギノ書体」を使用しております。



UD FONT  
by HIRAGINO

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。